

# Aufruf zur Vortragsanmeldung

Der Programmausschuss bittet um Anmeldung von Kurzvorträgen und Posterpräsentationen zu den nachfolgenden Symposiumsthemen:

- A - Polymermatrix-Verbundwerkstoffe (PMC)**
- B - Metallmatrix-Verbundwerkstoffe (MMC)**
- C - Keramikmatrix-Verbundwerkstoffe (CMC) und keramische Preforms**
- D - Durchdringungswerkstoffe**
- E - Werkstoffverbunde/Hybride/ Schichtwerkstoffe (Mischbauweisen/Hybride, Verbunde/Fügen)**
- F - Structural Health Monitoring (SHM) (Sensoren, Aktoren, Generatoren)**
- G - Beschichtungen (Funktionelle Schichten/Beschichtungsverfahren)**
- H - Modellierung, Simulation, Material-Design (Werkstoffe und Strukturen/Prozesse)**
- I - Recycling/Nachhaltigkeit (PMC, MMC, CMC)**
- J - Anwendungen/Produkte/Komponenten, Fertigungstechnologie (Marine, Windkraft, Maschinenbau, Luftfahrt, Fahrzeugbau)**
- K - Prüfung und Charakterisierung/Qualitätssicherung (PMC, MMC, CMC)**
- L - Hartmetalle, Cermets, Verschleiss/Abrasionswerkstoffe**
- M - Bio-Verbundwerkstoffe (Biomedizinische Verbundwerkstoffe, Bioinspirierte Materialien, Bionik, nachwachsende Rohstoffe)**
- N - Baustoffindustrie**

Die offizielle Konferenzsprache ist Deutsch, die Vorträge können aber auch in englischer Sprache abgehalten werden.

## Wichtige Termine

Vortragsanmeldung	30. September 2014
Autoreninformation	November 2014
Abgabetermin der Manuskripte	30. Januar 2015

Die eingereichten Manuskripte werden einem Review-Prozess unterzogen, erscheinen im TTP-Verlag und können deshalb nur in englischer Sprache angenommen werden. Ein entsprechender Tagungsband wird zur Veranstaltung vorliegen.

# Allgemeine Informationen

## Tagungsort

Technische Universität Wien · Karlsplatz 13 · 1040 Wien, Österreich  
[www.tuwien.ac.at](http://www.tuwien.ac.at)

## Hotelreservierung

Hotels in verschiedenen Preiskategorien sind in der Wiener Innenstadt für die Teilnehmer reserviert. [www.dgm.de/verbund/hotels](http://www.dgm.de/verbund/hotels)

## Veranstalter

Gemeinschaftsausschuss Verbundwerkstoffe (GAV)  
Deutsche Glastechnische Gesellschaft e. V. (Offenbach)  
Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e. V. (Frankfurt a. M.)  
Deutsche Gesellschaft für Galvano- und Oberflächentechnik e.V. (Hilden)  
Deutsche Keramische Gesellschaft e. V. (Köln)  
VDI-Gesellschaft Werkstofftechnik e. V. (Düsseldorf)  
Carbon Composites e.V. (CCeV)

## Tagungsleitung

Ass. Prof. Christian Edtmaier · Ass. Prof. Guillermo Requena  
Technische Universität Wien (AT)

## Tagungsorganisation

INVENTUM GmbH · Alexia Ploetz  
Postfach 20 07 14 · 53137 Bonn (DE)  
T +49 (151) 2122 7448 · [verbund@dgm.de](mailto:verbund@dgm.de)

## Tagungshomepage

[www.dgm.de/verbund](http://www.dgm.de/verbund)

## Ausstellung

Das Symposium wird von einer fachbezogenen Industrieausstellung begleitet. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Tagungsorganisation.

## Rahmenprogramm

Am Donnerstag haben die Teilnehmer die Möglichkeit zur Institutsbesichtigung und treffen sich dann abends in gemütlicher Atmosphäre zum Gesellschaftsabend.

# Verbundwerkstoffe

20. Symposium  
Verbundwerkstoffe und  
Werkstoffverbunde

1. - 3. Juli 2015  
Technische Universität Wien,  
Österreich

1. Einladung zur Vortragsanmeldung  
Beitragsdeadline 30. September 2014

# Zum Symposium

Das kommende Symposium „Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde 2015“ bietet in mehrfacher Hinsicht Gründe zur Rück-, aber auch Vorschau und steht unter dem Motto „2-20-200“, womit das Zusammentreffen gleich mehrerer Jubiläen beschrieben werden soll:

„2“: das Symposium findet nach 2003 zum zweiten Mal in Wien statt. Die Veranstaltung 2003 reiht sich unter diejenigen mit den meisten Teilnehmern ein und stand unter der hervorragenden Leitung und Organisation von Prof. H.-P. Degischer und seinem Team. Es ist klarerweise eine Herausforderung für das aktuelle Organisationskomitee, diese Teilnehmerzahlen wieder zu erreichen bzw. sogar zu übertreffen.

„20“: es ist das 20. Symposium für Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde, das seit 1974 im deutschsprachigen Raum stattfindet.

„200“: Die Technische Universität Wien wurde 1815 als „k. k. polytechnisches Institut“ gegründet und feiert damit im Jahr 2015 ihr 200-jähriges Bestehen.

Das Symposium soll auch 2015 ein Forum für alle jene Fachleute sein, welche an den zahlreichen Aspekten von Verbundwerkstoffen und Werkstoffverbunden interessiert sind. Dazu gehört es auch, „Werkstoffe nach Maß“ zu konzipieren und praktisch umsetzbar zu machen. Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde werden in zahlreichen High-tech-Produkten eingesetzt und bieten in allen technischen Anwendungen weiteres Potenzial zur Leistungssteigerung. Diese internationale, interdisziplinäre Tagung wird mit ihren spezifischen Problemlösungsansätzen weitere Innovationen stimulieren und die „technische Lernkurve“ in unterschiedlichen Anwendungsbereichen beschleunigen. „Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde 2015“ wird vom Gemeinschaftsausschuss Verbundwerkstoffe (GAV) der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde e.V. (DGM) gemeinsam mit der Technischen Universität Wien im Zeitraum 1.-3. Juli 2015 organisiert. Die Veranstalter laden die Fachwelt ein, Vorträge und Poster-Präsentationen zum aktuellen Stand der Technik und der Wissenschaft auf dem Gebiet der Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde in den jeweiligen Themenbereichen einzureichen und dann zum interdisziplinären Wissensaustausch nach Wien zu kommen.

**Christian Edtmaier · Guillermo Requena**  
Technische Universität Wien (AT)  
Vorsitzende des Programmausschusses



# Programmausschuss

Ass. Prof. Christian Edtmaier (Vorsitz)

Technische Universität Wien, Österreich

Ass. Prof. Guillermo Carlos Requena (Vorsitz)

Technische Universität Wien, Österreich

Prof. Vasiliki-Maria Archodoulaki

Technische Universität Wien, Österreich

Prof. Aldo R. Bocaccini

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Deutschland

Prof. Helmut Böhm

Technische Universität Wien, Österreich

Dr. Henri Cohrt

Carbon Composites e.V., Augsburg, Deutschland

Prof. Herbert Danning

Technische Universität Wien, Österreich

Prof. Heinrich Kern

Technische Universität Ilmenau, Deutschland

Dr. Dietmar Koch

DLR-Institut für Bauweisen- und Konstruktionsforschung Stuttgart, Deutschland

Dr. Thomas Konegger

Technische Universität Wien, Österreich

Prof. Walter Krenkel

Universität Bayreuth, Deutschland

Prof. Gunter Leonhardt

ProCon GmbH, Chemnitz, Deutschland

Dr. Daisy Nestler

Technische Universität Chemnitz, Deutschland

Prof. Wolfgang Paatsch

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin, Deutschland

Prof. Jürgen Stampfl

Technische Universität Wien, Österreich

Prof. Frank Vollertsen

Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH, Deutschland

Prof. Alexander Wanner

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe, Deutschland

Dr. Roland Weiß

Schunk Kohlenstofftechnik GmbH, Heuchelheim, Deutschland

Prof. Bernhard Wielage

Technische Universität Chemnitz, Deutschland

# Tagungsgebühren

## Universitätsangehörige < 31 Jahre

DGM-Mitglied*	250 EUR
DGM-Basis-Mitglied	280 EUR
Nicht-Mitglied	320 EUR

## Universitätsangehörige 31 - 40 Jahre

DGM-Mitglied*	450 EUR
DGM-Basis-Mitglied	480 EUR
Nicht-Mitglied	510 EUR

## Universitätsangehörige > 41 Jahre

DGM-Mitglied*	550 EUR
DGM-Basis-Mitglied	580 EUR
Nicht-Mitglied	610 EUR

## Industrie

DGM-Mitglied*	690 EUR
DGM-Basis-Mitglied	720 EUR
Nicht-Mitglied	750 EUR

\* Profitieren Sie von den günstigeren Mitgliedsgebühren.

Um Mitglied der DGM zu werden, registrieren sie sich bitte unter:  
[www.dgm.de](http://www.dgm.de).

In der Teilnahmegebühr sind der Tagungsband, die Kaffeepausen und der Gesellschaftsabend enthalten.

Der Gesellschaftsabend findet am 02. Juli im Palmenhaus, welches idyllisch, zentral im Burggarten mitten in der Wiener Innenstadt gelegen ist, statt.

## Best Poster / Best Paper

Die jeweils drei besten Poster und Paper werden im Rahmen der Tagung geehrt.

# Ausstellung und Anzeigenschaltung

## Ausstellung

Begleitend zur Tagung wird es eine Fachausstellung zentral in den Foyers der Technischen Universität Wien geben.

Der Preis je m<sup>2</sup> beträgt 195 EUR (zzgl. 19% MwSt)

Das Ausstellungspaket beinhaltet folgende Leistungen:

- Ausstellungsfläche ( mind. 6m<sup>2</sup>) für den eigenen Standbau (Standskizze mit Anmeldung erbeten)
- Veröffentlichung Ihres Firmenlogos und Firmenprofils (ca. 1.000 Zeichen) auf der Tagungshomepage und im Programmheft
- einen Ausstellerausweis, der auch zum Besuch des Fachprogrammes berechtigt

Strom, technische Unterstützung und Mobiliar können gerne separat auf Rechnung bestellt werden. Die Platzierung erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldungen.

## Anzeigenschaltung im Programmheft

Umschlagseite (U2, U4)	400 EUR
Umschlagseite (U3)	300 EUR
Innenseite 1/1	280 EUR
Innenseite 1/1 für Aussteller	230 EUR

Format: DIN A 4

Auflage: ca. 250 Exemplare

Ausgabetermin: Mai 2015

Abgabetermin: Druckvorlage bis 15. März 2015

# Sponsoring

## Konferenzmaterial

Konferenztasche (eigene Produktion)	1.500 EUR
Lanyards	500 EUR
Schreibblöcke	400 EUR
Kugelschreiber	300 EUR

Sie werden als Sponsor auf der Konferenzwebseite und im Programmheft genannt.

**Namensschilder** 500 EUR  
Ihr Firmenlogo wird auf dem persönlichen Namensschild der Teilnehmer gedruckt.

**Gastronomiesponsoring** min. 1.000 EUR (Preise auf Anfrage)  
Kaffeepause (Mi, Do oder Fr)  
Mittagssnack (Mi oder Do)  
Gesellschaftsabend (Do)

Ein Roll-up-Banner kann in dem Gastronomiebereich aufgestellt werden. Darüber hinaus werden Sie als Sponsor auf der Konferenzwebseite und im Programmheft genannt.

## Prospektmaterial

Flyer in der Tagungstasche	500 EUR
Flyer auf Stühlen im Plenarsaal	300 EUR
Flyerauslage am Check-in	150 EUR
Auslage von Give-aways am Check-in	150 EUR

*Alle o.g. Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.*

## Sie haben Interesse daran, Ihre Firma / Ihr Institut im Rahmen unserer Tagung zu präsentieren?

Mit den hier aufgeführten Aussteller- und Sponsorenleistungen bietet die Tagung die ideale Plattform Ihre Leistungen und Produkte einem ausgewählten Publikum zu präsentieren. Sollten Sie weitere Ideen für die Präsentation Ihres Unternehmens haben, sprechen Sie uns bitte an.